

電子機器の放熱にお困りですか？ "Thermalnite®"で高効率冷却

会社概要及び事業内容 Overview

名古屋大学発スタートアップ 株式会社U-MAP は、電子機器の熱課題を解決する高熱伝導材料を開発しています。独自素材 Thermalnite® を核に、EVやデータセンターなど高発熱分野向けの放熱ソリューションを提供しています。

主な事業 | Business

Thermalnite®事業

- ✓ 繊維状AINフィラー 「Thermalnite®」 の開発・製造
- ✓ 球状フィラーとのハイブリッド設計
- ✓ 試作～評価までの放熱材料開発支援

放熱シート事業

- ✓ 高熱伝導・低熱抵抗シリコーン放熱シート
- ✓ 業界最薄クラス 0.1mm 対応

セラミックス事業

- ✓ 高熱伝導・高強度 窒化アルミニウム基板



Thermalnite®
"サーマルナイト"
(ファイバ状窒化アルミニウム単結晶)

技術内容 Technology

●コア技術、提供価値 -Core Value-

Thermalnite® は、

繊維状の窒化アルミニウム単結晶フィラーです

- ✓ 少量添加で効率的な熱伝導経路を形成
- ✓ 热伝導率と機械特性を同時に向上
- ✓ 樹脂・セラミックスの性能を底上げ

放熱材料開発支援を本格始動

「開発支援型」で試作～評価を一貫サポート
お気軽にお問合せください！

●Thermalnite®添加した応用二次製品

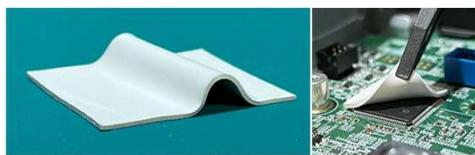
高強度AIN基板



- Thermalnite®添加で柱状組織を形成
- 機械特性を向上し、割れ・欠けを抑制
- 热伝導率230W+強度の両立

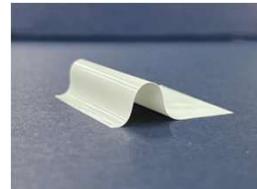
高熱伝導放熱シート

「業界トップクラスの高熱伝導と柔軟性」
最適なフィラー設計により2つを両立！



- 高熱伝導率 10.0 W/(m · K)
- 柔軟性により部品交差を吸収
- オイルフリーで実装部品の性能劣化を抑制

低熱抵抗放熱シート



- 热抵抗を15%低減（業界最小クラス）
- 0.1 mm薄型化と絶縁性を両立
- 機械強度 従来比4倍を達成

応用分野 Application

対象アプリケーション

